



Die-Bonder

5380

Die-Bond System

Bondkopf	Die-Bonding <ul style="list-style-type: none"> • manuelles Die-Bonden mit Touchdown-Detektion • programmierter Pickup- und Bondkraft • Bondkraftsystem mit Voice-Coil • kontaktloser elektronischer Touchdown-Sensor • verschiedene Pick-Up Tools einsetzbar • Bondkraftsystem mit Voice-Coil • kontaktloser elektronischer Touchdown-Sensor • Vakuum und Abblas-Gas automatisch geschaltet
Bondkraft	Bondkraft programmierbar von 5 bis 500 cN Pickup-Kraft programmierbar von 5 bis 500 cN

Maschinen Basis

Achsen	<ul style="list-style-type: none"> • Programmierbare lineare Z-Achse mit 60mm Hub • Programmierbare lineare Y-Achse mit 20mm Hub • Standard-Arbeitshöhe: 55 mm • Manipulator in X und Y: 18x18 mm • entspricht Untersetzung: 1:7
Hardware	<ul style="list-style-type: none"> • Stepper-Motor getriebene Z-Linearachse, • Singleboard-PC, menügeführtes Teach-In, • interne Festplatte, Bedienung und Menü- • Führung über Shuttlerad mit Quittierungstaster
Software	manueller, programmgestützter Produktionsablauf
Steuerung	Manuell, Teil-Automatisch
Abmessung	B x T x H – 63 x 58x 40 cm, Gewicht ca. 30kg
Anschlüsse	100-230 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max XXX VA Ø 6mm Standard-Vakuumschlauch
Heizung	Steuerung in der Maschine integriert 0-250 °C

Die 53xx Serie:

Unser beliebter manueller Drahtbonder 53XX BDA war schon bisher sehr vielseitig, weil er mit einfachstem Umbau sowohl Wedge- als auch Ball-Bonds herstellen kann. Jetzt kommt eine dritte Funktion dazu: der 53XXBDA kann jetzt auch Dies bonden!

Am Bonder sind nur minimale Erweiterungen in Hard- und Software nötig. Statt des Drahtbondwerkzeugs wird direkt in den Transducer ein Adapter eingesetzt, um Standard-Tools zum Chipbonden, sogenannte Die-Collets, aufzunehmen. Diese gibt es auf dem Markt in unterschiedlichen Schaftdurchmessern, aber sie passen alle in die drei vorgesehenen Aufnahmebohrungen. Die Chips werden in Wafflepacks angeliefert, die neben der normalen Bauteil-aufnahme befestigt werden.

Besonders attraktiv ist, dass der Bonder in Minutenschnelle wieder auf das Drahtbonden umgestellt ist. Wenn die Schaltung mit den platzierten Chips also ausgehärtet aus dem Ofen kommt, ist der Bonder schon wieder bereit für das anschließende Drahtbonden.

Substrathalter

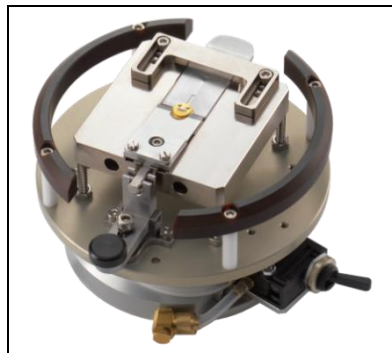
Standard-Substrataufnahme
Mit mechanischer Klemmung
Ø80mm



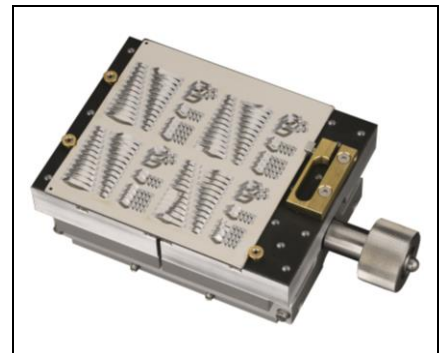
Optional:



Substrataufnahme
für Bauteile bis 4x4" mit
Vakuum und mech. Klemmung



TO Aufnahme mit
mechanischer Klemmung



4x4" Substrataufnahme m.
gummierter Oberfläche, mit
mechanische Klemmung

F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a

A-5280 Braunau am Inn

Tel.: +43-7722-67052-8270

Fax: +43-7722-67052-8272

Mail: info@fsbondtec.at

Web: www.fsbondtec.at

